

## FC-BGA基板の技術・市場動向-2023-

- ・発刊日：2023年11月6日
- ・納品形態：ハードコピー1部(255頁)、CD1枚
- ・価格：コーポレート契約：¥660,000-(税込)  
グローバル契約：¥880,000-(税込)

**\*前回購入者限定価格：上記金額より25%割引いたします**

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ

〒103-0004東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋榎町ビル8F

| TEL: 03-5829-3891 | FAX: 03-5829-3892 | E-mail: info@jms21.co.jp | <https://www.jms21.co.jp>

## ◆先端ICパッケージ(HPC向け)の技術動向

- ・IC別パッケージ技術ロードマップ
- ・主要企業のパッケージ技術動向

## ◆FC-BGA基板の市場動向

- ・市場規模を層数別、IC別、応用別に分類し、販売金額/数量/面積から市場動向を分析・予測する

\*層数別：～2-n-2, ～4-n-4, ～6-n-6, ～8-n-8, 9-n-9～, coreless, 2.xD PKG

\*IC別：MPU, GPU, Chipset, FPGA/ASIC

\*応用分野別：PC, Server/AI, Game/Tablet, Network, Auto, Others

- ・市場の需給動向をServer/AI、PC、その他の用途別に分析・予測する
- ・主要メーカーの販売状況を応用別に分類し、供給の半導体メーカーを分析する
- ・主要FC-BGA基板メーカーの企業事例研究を掲載

項目	頁
第1章 総論	1
FC-BGA基板の市場概況	2
FC-BGA基板の需給分析	5
PC用FC-BGA基板の市場概況	8
Server/AI用FC-BGA基板の市場概況	10
Game/Tablet用FC-BGA基板の市場概況	12
Network用FC-BGA基板の市場概況	14
Auto用FC-BGA基板の市場概況	16
主要パッケージ基板メーカーの販売ランキング	18
主要半導体メーカーの購入ランキング	19
PC用FC-BGA基板の採用状況	20
Server/AI用FC-BGA基板の採用状況	21
Game/Tablet用FC-BGA基板の採用状況	22
Network用FC-BGA基板の採用状況	23
Auto用FC-BGA基板の採用状況	24
主要パッケージ基板メーカーの販売動向	25

# 目次

項目	頁
主要パッケージ基板メーカーのFC-BGA基板向け設備投資動向	27
FC-BGA基板の製品動向(ロードマップ)	31
第2章 先端ICパッケージの技術動向	33
1. Siノードの微細化	34
2. IC別パッケージ技術ロードマップ	38
3. 2.5D系パッケージの種類と概要	40
4. Siインターポーザの動向	41
5. 主要企業のパッケージ技術動向(TSMC, Intel, Samsung, 新光電気)	42
第3章 FC-BGA基板の市場動向	54
3-1. 市場規模予測(2022-2032)	55
FC-BGA基板の応用別市場規模予測(金額、数量、面積)	56
FC-BGA基板の層数別市場規模予測(金額、数量、面積)	64
3-2. 応用分野別市場規模(2022)	72
PC向け市場規模(金額、数量、面積)	73
Server/AI向け市場規模(金額、数量、面積)	74
Game/Tablet向け市場規模(金額、数量、面積)	75

項目	頁
Network/Auto/Others向け市場規模(金額、数量、面積)	76
3-3. 主要基板メーカーの販売規模(2022)	77
主要基板メーカーの応用分野別の販売規模(金額、数量)	78
主要基板メーカーの層数別販売規模(金額、数量)	81
PC向けMPU用途(金額、数量)	83
PC向けGPU用途(金額、数量)	86
PC向けChipset用途(金額、数量)	89
Server/AI向けMPU用途(金額、数量)	92
Server/AI向けGPU用途(金額、数量)	95
Server/AI向けFPGA/ASIC用途(金額、数量)	98
Game/Tablet向けMPU用途(金額、数量)	101
Game/Tablet向けGPU用途(金額、数量)	104
Network向けFPGA/ASIC用途(金額、数量)	107
Auto向けFPGA/ASIC用途(金額、数量)	110
Auto向けGPU用途(金額、数量)	113
Others向けFPGA/ASIC用途(金額、数量)	116

# 目次

項目	頁
3-4. 主要基板メーカーの半導体メーカーへの供給状況(2022)	119
PC向け(金額、数量)	120
Server/AI向け(金額、数量)	122
Game/Tablet向け(金額、数量)	124
Network向け(金額、数量)	125
Auto向け(金額、数量)	127
Others向け(金額、数量)	129
3-5. 主要半導体メーカーの購入状況(2022)	130
PC向け(金額、数量)	131
Server/AI向け(金額、数量)	132
Game/Tablet向け(金額、数量)	133
Auto向け(金額、数量)	134
Network/Others向け(金額、数量)	135
第4章 企業事例研究	136
4-1. 日本メーカー	137
IBIDEN CO., LTD.	138

項目	頁
SHINKO ELECTRONIC INDUSTRIES CO., LTD.	146
KYOCERA Corporation	154
TOPPAN INC.	163
4-2. 台湾メーカー	174
Unimicron Technology Corporation	175
Nan Ya PCB Corporation	184
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP.	194
Zhen Ding Technology Holding Limited	202
4-3. 韓国メーカー	208
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	209
LG Innotek Co., Ltd.	217
SIMMTECH Co., Ltd.	225
KOREA CIRCUIT CO., LTD.	231
DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd.	239
4-4. 欧米メーカー	247
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft	248

## 1. 契約形態/価格

◆コーポレート価格：660,000円(税込)〔レポート本体+CD〕

◆グローバル価格：880,000円(税込)〔レポート本体(日本語版、英語版)+CD〕

※ ご利用はコーポレート契約では同一法人内に限定され、グローバル契約は出資比率51%以上の子会社までとなります

## 2. 発刊日：2023年11月6日

## 3. お申し込み方法

添付の調査申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛までFAX(03-5829-3892)もしくは電子メール(info@jms21.co.jp)にてご送付下さい。

## 4. お支払い条件

請求書発行日の翌月末日までに銀行振込にて、お支払い下さい。

## 5. 調査レポートのお取り扱い

上記のご契約形態に従ってその利用範囲を限定させていただきます。

その契約形態を越えての第三者への譲渡を禁止とし、お約束いただきます。



# 申 込 書

JMS

年 月 日

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ 様 FAX:03-5829-3892 (または[info@jms21.co.jp](mailto:info@jms21.co.jp))

## FC-BGA基板の技術・市場動向-2023-

申し込み形態(チェック☑お願いいたします): コーポレート契約 グローバル契約

※前頁の「調査レポートのお取り扱い」について合意の上 申し込みします。

申込企業名: \_\_\_\_\_.

申込責任者: \_\_\_\_\_ 印 同役職: \_\_\_\_\_.

連絡担当者: \_\_\_\_\_.

同 所 属: \_\_\_\_\_.

所 在 地:(〒 \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_.

TEL: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_.

金額: \_\_\_\_\_ (税込)

連絡事項: